

Grundsteinlegung 300-Millimeter-Halbleiterwerk Dresden

25. Juni 2018

PI 10675 AE Ka/af

Allgemeine Informationen

- ▶ Investitionssumme
rund eine Milliarde Euro
- ▶ Grundstück
ca. 100 000 m²
(ca. 14 Fußballfelder)
- ▶ Gesamtnutzfläche
ca. 72 000 m² Fertigungs-
und Büroflächen
- ▶ Bauverlauf
Spatenstich Frühjahr 2018
Maschineninstallation Mitte/Ende 2019
Pilotproduktion ab Ende 2021
- ▶ Mitarbeiter im Endausbau
bis zu 700
- ▶ Gesuchte Berufsqualifikationen
Experten aus der Halbleiterindustrie,
wie Prozess-, Produktions- oder
Instandhaltungsingenieure,
Mathematiker, Softwareentwickler
sowie Berufserfahrene aus
Studienrichtungen wie Physik, Chemie
und Mikrosystemtechnik
- ▶ Fertigungstechnologie
Hochautomatisierte Halbleiterproduktion
(300-mm-Siliziumsubstrate (Wafer)
mit Strukturbreiten bis 65 nm;
1 nm ist ein Millionstel Millimeter)

- ▶ Vernetzte Produktion
Pro Sekunde übertragen die Maschinen ein Gigabit Produktionsdaten. Täglich entstehen Datenmengen, die umgerechnet mehr als 42 Millionen beschriebene Blatt Papier mit einem Gewicht von 22 Tonnen ergäben.

Informationen zum Bauwerk

- ▶ Gesamtbaumasse 600 000 m³
- ▶ Betonbedarf ca. 66 500 m³
(etwa 8 300 LKW-Betonmischer)
- ▶ Stahlbedarf ca. 16 400 Tonnen
(etwa 30 A380-Passagierflugzeuge)
- ▶ Erdbewegungen/-aushub ca. 90 000 m³
(etwa 7 500 Lkw-Ladungen)
- ▶ Bohrfähle für das Fundament ca. 860 Stück
- ▶ Bodenplatte 100 cm Dicke
- ▶ Länge der Rohrleitungen ca. 80 km
- ▶ Länge der Elektroleitungen ca. 380 km
(2 x Strecke Berlin-Dresden)

Internetquellen

- ▶ Stellenbörse für Bewerber www.bosch-career.de/jobs
- ▶ Standortseite Dresden www.bosch.de/unternehmen/bosch-in-deutschland/dresden
- ▶ Halbleiter von Bosch www.bosch-semiconductors.com